## Yolita Eggeler

Microscopy of Nanoscale Structures & Mechanisms (MNM), Laboratorium für Elektronenmikroskopie (LEM), Gebäude 30.25, Raum 215; Tel: 608-43724; Email: <u>yolita.eggeler@kit.edu</u>

#### 1. Rasterelektronenmikroskopie

- 1.1 Funktionsprinzip des Rasterelektronenmikroskops
- 1.2 Wechselwirkung zwischen Primärelektronen und Probe
- 1.3 Apparative Aspekte
- 1.4 Abbildungsmodi
  - Abbildung mit Rückstreuelektronen
  - Abbildung mit Sekundärelektronen

Channeling (Orientierungskontrast)

- Elektronenrückstreubeugung (EBSD: Electron Backscatter Diffraction)
- 1.5 Environmental Rasterelektronenmikroskopie
- 1.6 Abbildung mit elektronenstrahlinduzierten Strömen (EBIC: electron-beam induced

- 1.7 Kathodolumineszenz
- 1.8 Prüfen elektronischer Bauelemente / Spannungskontrast
- 1.9 Elektronenstrahllithographie

Topographie- und Materialkontrast mit dem Everhardt-Thornley Detektor

Effekte:

Anzahl der erzeugten SE bzw. RE

<u>Rückstreukoeffizient</u>  $\eta$  = Anzahl der RE / Primärelektron

abhängig von

- a) Winkel zwischen Probenoberfläche und Primärelektroneneinfallsrichtung
- b) Ordnungszahl  $\rightarrow$  Materialkontrast

<u>Sekundärelektronenausbeute</u>  $\delta$  = Anzahl der SE / Primärelektron

abhängig von

- a) Winkel zwischen Probenoberfläche und Primärelektroneneinfallsrichtung
- b) Ordnungszahl/Materialkontrast schwach
- Kollektionswinkelbereich des Detektors

#### Rückstreuelektronenkoeffizient (Messdaten)



Fig. 4.7. Increase of the backscattering coefficient  $\eta$  of 25.2 keV electrons with increasing atomic number Z for different tilt angles  $\phi$  ( $\phi = 0$  : normal incidence) [4.1]

- $\eta$  abhängig vom Einfallswinkel  $\varPhi$  der Primärelektronen
  - → Topographiekontrast
- $\eta$  abhängig von der Ordnungszahl Z
  - → Materialkontrast
- optimaler Materialkontrast bei senkrechtem Einfallwinkel

$$\eta_{(Z,\phi)} = (1 + \cos\phi)^{\frac{-9}{\sqrt{Z}}}$$

Andere Fitfunktionen für  $\eta$  (siehe L. Reimer, Kap. 4)

L. Reimer, "Scanning electron microscopy", Abb.4.7

# Sekundärelektronenausbeute in Abhängigkeit vom Primärelektroneneinfallsrichtung und der Elektronenenergie, Materialabhängigkeit



SE Ausbeute  $\delta$  = Anzahl der SE pro Primärelektron

- Zunahme der SE Ausbeute mit dem Einfallswinkel  $\Phi$ 
  - Abbildung der
     Oberflächentopographie
- SE Ausbeute nur schwach vom Material abhängig
- Abnahme der SE Ausbeute mit zunehmender Energie der Primärelektronen E<sub>0</sub>

Fit der experimentellen Daten durch:

$$\delta \propto E_0^{-0.8}$$

L. Reimer, "Scanning electron microscopy", Abb.4.17

Fig. 4.17a, b. Decrease of the

secondary electron yield  $\delta$  with

increasing electron energy E for (a) Al and (b) Cu and different

tilt angles  $\phi$  ( $\phi = 0$ : normal

incidence) in a double-logarith-

mic plot which confirms the relation  $\delta \propto E^{-0.8}$  [4.1]

# Kapitel 1.4: Abbildungsmodi

### Abbildung mit Sekundärelektronen: Kanteneffekt



P.F. Schmidt, "Praxis der Rasterelektronenmikroskopie und Mikrobereichsanalyse", Abb.5.20 und 5.21 SE Abbildungen mit dem Everhardt Thornley Detektor für unterschiedliche Primärelektronenenergien



Kontrast und Helligkeit bei 30 keV Bild geändert

#### Gesamtausbeute an RE und SE in Abhängigkeit von E<sub>0</sub>



Gesamtelektronenausbeute  $\sigma$ 

 $\sigma = \delta + \eta$ 

Probenaufladung bei elektrisch schlecht leitenden Proben, wenn  $\sigma \neq 1$ 

Bild 5.15\*: SE-Ausbeute  $\delta$ , Rückstreukoeffizient  $\eta$  und die Gesamtausbeute  $\sigma$  von der Energie der PE,  $\sigma = \delta + \eta$ , Präparat: polykristalline Cu-Oberfläche

P.F. Schmidt, "Praxis der Rasterelektronenmikroskopie und Mikrobereichsanalyse", Abb.5.15

## Channeling von Rückstreu- (und Sekundär)elektronen (Orientierungskontrast)



- Abhängigkeit von δ und η vom Winkel zwischen
   Primärelektronenstrahl und Ebenen des Kristallgitters
   → Abbildung von Körnern eines polykristallinen Materials
   → Abbildung von Gitterdefekten
- Voraussetzung ist sehr glatte Oberfläche durch (elektro)chemische Politur
- schwacher Effekt im Vergleich zu Topographie- und Materialkontrast

**Fig. 6.17 a, b.** Crystal orientation contrast in a BSE micrograph of an electrolytically polished, polycrystalline copper specimen. Note the change of contrast of single grains when the specimen is tilted through 1° between (**a**) and (**b**) [6.35]

L. Reimer, "Scanning electron microscopy", Abb.6.17

#### Channeling von Rückstreuelektronen (Orientierungskontrast)



P.F. Schmidt, "Praxis der Rasterelektronenmikroskopie und Mikrobereichsanalyse", Abb.5.32 und 5.33

Experimentelle Voraussetzungen:

- chemisch polierte, sehr glatte Oberfläche (SE Channeling: saubere, strukturell nicht gestörte Oberfläche)
- hoher Strahlstrom f
  ür akzeptables Signal/Rausch-Verh
  ältnis
- kleiner Strahlkonvergenzwinkel

Einfache qualitative Erklärung: geringe Rückstreuung, wenn PE parallel zu Kristallebenen mit (großem) Ebenen-Abstand propagieren

## <u>Elektronenrückstreubeugung (Electron Backscatter Diffraction: EBSD)</u> → <u>Beugungstechnik (!)</u>

Analyse von

- Kristallstruktur, Phasenanalyse in Kombination mit chemischer Analyse (EDXS)
- Kornorientierungen bei bekannter Kristallstruktur (Texturanalyse)
- Korngrenzenkristallographie



## Stationärer Elektronenstrahl!



P.J. Goodhew, J. Humphreys, R. Beanland, Electron Microscopy and Analysis, Abb.5.23

Erste Veröffentlichung: D.J. Dingley, V. Randle, J. Mat. Sci. 27, 4545 (1992)

Elektronenmikroskopie II / Yolita Eggeler

## **Kikuchi-Linien**

Zweistufiger Entstehungsmechanismus

Inelastischer Streuprozess mit geringem Energieverlust Aufweitung des Elektronenstrahl



Einfallende

## Texturanalyse mit EBSD



Schematic Representation of Sample Normal COM

- 1. Orientierungsbestimmung von (vielen) Körnern
- 2. Kornorientierungsverteilungen (Auftragung in Polfigur)
- 3. Textur: bevorzugte Ausrichtung von Körnern in einer kristallographischen Richtung

#### Stereographische Projektion und Polfigur zur Darstellung von Kristallorientierungen



- Durchstoßpunkte der Ebenennormalen des Kristalls mit umgebender Kugel
- Für Durchstoßpunkte auf der Nordhalbkugel: Verbindung der Durchstoßpunkte mit "Südpol" der Kugel
- Standarddreieck gegeben durch Durchsto
  ßpunkte der Richt
  ungen [001], [101] und [111] in der Äquatorebene Ebene (blau)

Projektion von Richtungen im 3-dimensionalen Raum auf 2 Dimensionen am Beispiel eines kubischen Kristalls



Charakterisierung von Korngrenzen

P.J. Goodhew, J. Humphreys, R. Beanland, Electron Microscopy and Analysis, Abb.5.24 c,d

- Bestimmung der Kornorientierungen mit EBSD
- Polfiguren: Darstellung der Häufigkeit von Kornorientierungen in stereographischer Projektion
- Darstellung der Häufigkeit von Winkeln zwischen benachbarten Körnern (Unterscheidung zwischen Kleinwinkel- und Großwinkelkorngrenzen)

Elektronenmikroskopie II / Yolita Eggeler

## <u>EBSD</u>

Kornorientierungen in einer Absorberschicht einer Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub> Solarzelle

(b,c) Darstellung des Signal-zu-Rauschverhältnisses der EBSD Muster zur Visualisierung von Korngrenzen



Lukas Pfaffmann, Diplomarbeit 2013 (LEM)



## <u>EBSD</u>

Phasenanalyse mit Kristallstrukturbestimmung durch EBSD und Analyse der chemischen Zusammensetzung mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDXS)



1. Positionierung des Elektronenstrahls

Phasenanalyse mit Kristallstrukturbestimmung durch EBSD und Analyse der chemischen Zusammensetzung mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDXS)



Energie der Röntgenphotonen

- 1. Positionierung des Elektronenstrahls
- 2. EBSD und EDXS-Spektrum an gleicher Probenposition
- 3. Quantitative Auswertung des EDXS Spektrums (Al<sub>0.5</sub>N<sub>0.5</sub>)

#### Kristallstrukturanalyse mit EBSD



4. Quantitative Auswertung des EBSD-Musters: hexagonale Wurtzitstruktur

#### Ergebnis:

Korn aus AIN mit hexagonaler Wurtzitstruktur

AlN, Hexagonal, SG 186, (NIST Structural Database)

Elektronenmikroskopie II / Yolita Eggeler